

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2022-009

# 广东正业科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为永拓会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 368,940,250 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

## 二、公司基本情况

### 1、公司简介

股票简称	正业科技	股票代码	300410
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王巍	陈丽暖	
办公地址	东莞市松山湖园区南园路 6 号	东莞市松山湖园区南园路 6 号	
传真	0769-88774271	0769-88774271	
电话	0769-88774270	0769-88774270	
电子信箱	ir@zhengyee.com	ir@zhengyee.com	

## 2、报告期主要业务或产品简介

### (一) 主要业务

正业科技聚焦“工业检测智能装备”主航道，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、PCB、平板显示”三大主业，积极进军半导体领域。正业科技主要面向锂电、半导体、PCB、平板显示等行业制造厂商提供工业检测智能装备等相关产品和服务，拥有较为完善的产业链布局和众多稳定、优质的知名客户，目前市场覆盖全球数十个国家和地区，具备较强的行业综合服务能力，为客户提供多方位的标准化、定制化服务及解决方案，满足全球不同客户的差异化需求。

### (二) 主要产品

#### 1、锂电板块

公司的锂电检测自动化是向锂电池制造厂商提供锂电智能检测设备，对锂电池内部缺陷进行无损检测分析，提高锂电池的安全性和可靠性，满足新能源汽车及各种电子产品的锂电池检测需求。公司在锂电检测细分领域优势突出，技术水平、产销规模、服务能力等方面均具有行业领先优势，获得锂电行业龙头企业的高度认可，与宁德时代、珠海冠宇、蜂巢能源、比亚迪、中航创新、亿纬锂能、孚能科技、正力新能源、欣旺达、维科电池、国轩高科、松下能源、瑞浦能源、赣锋锂业等锂电池制造厂商保持稳定合作关系。

公司锂电板块的主要产品情况如下：

产品名称	产品用途	产品特点	产品图片
方形聚合物软包电芯/成品电池全自动 X 光检查机	该设备主要应用于方形聚合物软包电芯或成品电池进行在线全自动检测。	1、软件功能丰富： A、自动测量电池正负极片对齐度，统计最大值、最小值、均值、正极差、负极差； B、自动判断良品和不良品，自动分拣不良品； C、扫码功能，记录电池编码，逐个跟踪电池检测结果并可上传到终端服务器。 2、检测效率高：一套成像系统，两套入料机械手交替运行，实现在线检测分析，效率高，日检 30K 以上，适合对方形聚合物软包电芯或成品电池进行大批量全检。 3、生产线对接：出入料口可对接生产线。 4、换型调试快：不同型号电池换型调试快，更换时间在 10-30 分钟内。 5、安全环保：整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部分均满足安全辐射标准。	
圆柱电池全自动 X 光检查机	该设备主要应用于锂电行业圆柱型电池的在线或离线全自动检测。	1、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。 2、实时监测 对所有动作、信号、硬件状态实时监测，并呈现在软件操作界面上。 3、图像和数据实时在线显示 同一电池的多部位检测图片和数据，在同一软件界面中显示，方便观察识别； 4、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部位均满足欧美国家安全辐射标准。	

<p>多层卷绕动力电池全自动 X 光检查机</p>	<p>该设备主要应用于电池行业多层卷绕型动力电池的在线全自动检测。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品。</li> <li>2、数据库建模 客户可据检测标准自由设定，建模型号多达 60 种；设备通过读取条形码或二维码，进行自动切换。</li> <li>3、实时监测 对所有动作、信号、硬件状态实时监测，并呈现在软件操作界面上。</li> <li>4、OK 品电池智能配对 软件自动判定 AB 型号电池，AB 型号配对流往下一道工序。</li> <li>5、图像和数据实时在线显示 同一电池的多部位检测图片和数据，在同一软件界面中显示，方便观察识别。</li> <li>6、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部位均满足安全辐射标准。</li> </ol>	
<p>叠片动力电池全自动 X 光检查机</p>	<p>该设备主要应用于叠片型动力电池的在线全自动检测。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。</li> <li>2、实时监控 对所有动作，信号，硬件状态实时监控，并呈现在软件操作界面上。</li> <li>3、图像和数据保存 同一电池的多部位检测图片和数据、在同一软件界面中显示，方便观察识别。</li> <li>4、安全环保 整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部件均满足欧美国家安全辐射标准。</li> </ol>	
<p>叠片电池 / 圆柱电池全自动 TDI 线扫 X 光检查机</p>	<p>该设备主要应用于锂电行业热压后的动力叠片电芯或圆柱电池的在线 / 离线全自动检测。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、检测范围广 TDI 线扫一次检测范围广，成像畸变小，对电池层数没有限制；</li> <li>2、全自动检测 自动检测判断，自动分拣良品与不良品，能适应在线和离线两种检测方式的需要。</li> <li>3、实时监控 对所有动作，信号，硬件状态实时监控，并呈现在软件操作界面上。</li> </ol>	

2、半导体板块

基于战略及业务发展需要，公司于 2021 年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X 光检测技术”应用于半导体封装测试阶段，针对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发的半导体分立元件在线全自动 X-RAY 检测设备为半导体行业客户解决了检测效率的难题。报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了 8 台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的 X-ray 点料机、半自动 X 光检测设备也获得了汽车电子、SMT 行业大客户的设备订单，公司在半导体板块布局初见成效。

公司半导体板块的主要产品情况如下：

产品名称	产品用途	产品特点	产品图片
全自动芯片缺陷 X 光检查机	<p>该设备具有一套 X-ray 成像系统，四轴机器人自动上下料，针对半导体行业内的分立元件进行在线全自动检测，可适应 7 英寸、11 英寸、13 英寸的料盘。</p> <p>设备通过 X-ray 发生器发出 X 射线，穿透芯片内部，由平板探测器接收 X 射线进行成像，通过图像算法对图像进行分析、判断，确定良品与不良品，并通过复盘功能，确定芯片在料盘中的序号，以便后端将不良芯片挑出。</p>	<p>一、算法软件功能强</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>自主研发的复盘算法能够实时复盘，边采图边复盘。</li> <li>人机交互功能丰富。界面图片可拖拽、缩放，可在复盘图上双击 NG 芯片，即可索引并显示出该芯片的原图、NG 类型等信息。</li> <li>自主研发的检测算法能够自动准确地检测芯片的线型及芯片导体等不良项。</li> <li>软件具备扫码、MES 上传、人工复判等功能。</li> </ol> <p>二、检测效率高</p> <p>整盘矩阵式采图，无需拉料卷料；具有 CCD 视觉定位系统，机器人自动上料。7 英寸料盘检测用时 3min(3000pcs)。</p> <p>三、生产线对接</p> <p>具备与 AGV 对接功能。</p> <p>四、安全环保</p> <p>整个设备安全互锁，三重防护功能，机身表面任何部位均满足安全辐射标准。</p>	
智能点料机	<p>该设备应用于 SMT 行业，可对整盘物料进行快速点数，包括但不限于检测电容、二极管、三极管等分立元件。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>点料精度高；</li> <li>检测速度快；</li> <li>可对接 MES/ERP/WMS 等系统；</li> <li>安全可靠：出料防夹功能；</li> <li>条码扫码、标签打印一对一数据绑定</li> </ol>	



### 3、PCB 板块

#### (1) PCB 智能检测设备

公司的 PCB 智能检测设备产品种类覆盖 PCB/FPC 生产全工艺流程，如线宽、铜厚、板厚、检孔、翘曲度、外观、阻抗、离子污染等检测设备，满足多种检测需求。公司在 PCB 行业拥有 23 年多的技术沉淀，积累了丰富的项目经验和客户资源，拥有鹏鼎控股、健鼎科技、美维、深南电路、沪电股份、胜宏科技、景旺电子、生益科技、兴森科技、明阳电路、博敏电子、崇达技术、奥士康、超声电子、杰赛科技等行业知名客户。

公司 PCB 智能检测设备的主要产品情况如下：

产品名称	产品用途	产品特点	产品图片
------	------	------	------

<p>自动线宽测量仪</p>	<p>自动线宽测量仪适用于检测 PCB 内、外层蚀刻后(上绿油前)线路的上幅及下幅宽度、也可测量蚀刻线与线之间的距离、孔到边的距离、焊盘、PAD 以及圆孔直径等;并适用于 IC 晶片和 LCD 等线宽线距测量。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、自动定位测量:支持 CAM 资料导入、用户可使用 ODB++格式文件进行自定义测量位置信息编程、生成自动测量程序后可导入软件自动测量;</li> <li>2、自动对焦:自动运行时、成像系统自动对焦、保证测量位置清晰准确;</li> <li>3、自动切换倍率:采用自动变倍镜头、无需人工切换、可软件实现在线切换倍率;</li> <li>4、导航快速定位:具备导航影像定位功能、方便查找测量点;</li> <li>5、自动寻边测量:软件可自动抓线寻边、同时测量上下幅线宽、线距、圆直径等;</li> <li>6、数据统计功能:具备 EXCEL 数据自动导出功能。</li> </ol>	
<p>在线铜厚测试仪</p>	<p>在线铜厚测试仪用于硬板、单层或多层线路板表面铜厚的测量。 适用制程:VCP 电镀监控,前端表面处理产线前段/后段监控,或离线自动化检测。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、原创发明,双面检测原理发明专利;</li> <li>2、专利解析,自动解析识别孔位;</li> <li>3、专利分析,智能自动选取测试点;</li> <li>4、连接检测,预防不良产出,杜绝客诉;</li> <li>5、连接检测,MSA 对接,大数据分析质量管控;</li> <li>6、连接检测,智能管控 VCP 及前处理和蚀刻产线参数;</li> <li>7、离线检测,提高测试效率,减少人力,及记录和测试误差。</li> </ol>	
<p>PCB 钻靶上料机</p>	<p>用于 X-Ray 钻靶机自动上料,含自动定位自动调整角度,自动翻板,替代人工上料,产速稳定,适合高度自动化产线作业。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、适应不同尺寸 PCB 硬板上料,自动识别工作板(方向孔)方向;</li> <li>2、批量投料,设计旋转、翻转/存储一体功能,连续不间断投料;</li> <li>3、不良品分堆功能,配合 X-Ray 实现靶距异常分堆,分堆后批量投料管制;</li> <li>4、前端预留全自动连线接口,配合自动分板机自动仓储(另配仓储系统);</li> <li>5、选配打码标识,采用水性油墨,不对产品造成影响。</li> </ol>	
<p>半固化片无尘自动裁切机</p>	<p>适用于对半固化片卷料进行分条分块裁切,解决裁切过程中粉尘过大等问题,提高裁切精度、品质及效率。</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、技术创新: 首家使用红外加热技术;</li> <li>2、低粉尘、环保型: 先加热再裁切,自动封边,无拉丝;增加吸尘装置,通过详细的计算及流体分析,降低粉尘,环保健康;</li> <li>3、精准: 采用高精度的传动机构和同步伺服控制系统,裁切精度高;</li> <li>4、高质: 裁切的 PP 片切口整齐,自动封边,无拉丝;</li> <li>5、高效: ①横切、纵切动态加热,提升裁切效率; ②裁切后的 PP 片可直接使用,无需后续封</li> </ol>	



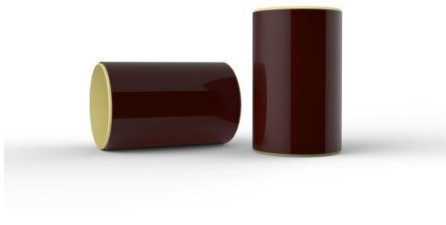


		边、吸尘等工序； ③裁切的精度进一步提高，裁切效率进一步提高； ④PP 片可自动堆叠； ⑤参数打包，直接调出。	
--	--	--	--

(2) FPC 材料

公司研发生产的 FPC 高端材料广泛应用于 5G 通讯、智能安防、智能车载、电动汽车和 OLED 等多个领域。材料供应一应俱全，满足客户一站式采购需求，拥有景旺电子、上达电子、合力泰、安捷利、奈电科技等行业知名客户。

公司 FPC 材料的主要产品情况如下：





产品名称	产品用途	产品特点	产品图片
覆盖膜	1、覆盖和保护 FPC 线路，增强 FPC 的耐挠折性； 2、保护线路不受温度、湿度、有污染或侵蚀性物质的伤害； 3、为 FPC 后续的表面处理进行覆盖； 4、在 FPC 后续的 SMT 中，起阻焊作用。	1、能同时适合传统和快速压合方式； 2、长期耐热性好、剥离强度高； 3、良好的溢胶量控制； 4、优越的挠曲性，适合于高折曲软板； 5、耐化学性好，阻燃性佳 (UL-94V0) , ul 认证号：E467827； 6、储存稳定性好； 7、满足 RoHS 指令要求，不含铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯、多溴联苯醚、红磷。	
电磁屏蔽膜	电磁屏蔽膜主要用于挠性电路板 (FPC)，通过导电胶层与 FPC 的接地金面导通，用于屏蔽信号，防止 FPC 的线路及元器件在传输信号时受到外界干扰。	1. 优良的耐热性； 2. 优异的屏蔽效能； 3. 优良的耐化学性； 4. 高挠曲性能。	
PI 补强板	PI 补强板又叫 Polyimide Stiffeners、加强板、增强板。产品主要分为有胶补强板和无胶补强板两种，在电子产品中被广泛使用，主要解决柔性电路板的承载能力差的问题，提高承载部位的强度，方便产品的整体组装。	1、优良的耐热性； 2、优良的平整性； 3、优良的耐化学性； 4、优良的机械性和电性能； 5、无卤无锑，UL-94V0 的阻燃等级。	

4、平板显示板块

公司的平板显示模组自动化业务处于产业链中游，主要向平板显示制造厂商提供用于平板显示器中显示模组组装生产的邦定、贴合、背光等中后段模组全自动化生产线，与京东方、华星光电、信利光电、夏普、业成、天马、维信诺、联创电子、同兴达、德普特等平板显示行业主要厂商建立了长期合作关系。

公司平板显示板块的主要产品情况如下：

产品名称	产品用途	产品特点	产品图片
------	------	------	------

<p>全自动小尺寸 OLED 贴合线</p>	<p>设备为适用贴附多种形状的 cover lens (包含单曲, 双曲, 三曲, 四曲等曲面盖板) 与柔性 OLED 的贴合, OLED、CG、OCA 上料机送料, OLED 自动覆制程承载膜, 自动钢带 sheet 贴 OLED+OCA, OLED 与曲面 Lens 仿形真空贴合, 精度检测, 自动解胶并撕除承载膜, 最后自动下料的全自动曲面贴合线。</p>	<p>产品工艺: CG+OCA+OLED 对应尺寸: 3-8 寸 设备精度: ±0.1mm 设备节拍: 10.0S/Pcs 设备良率: 99%</p>	
<p>全自动中尺寸背光组装机</p>	<p>设备为 LCD/BL 自动上料-撕膜对位-自动 LCD+BL 贴合-保压-精度检测-自动下料的全自动中尺寸 BL 组装机。</p>	<p>产品工艺: 对应尺寸: 7-17 寸 设备精度: ±0.1mm 设备节拍: 6.0S 设备良率: 99.5%</p>	
<p>全自动中尺寸 OCA 贴合线</p>	<p>设备为 CG/OCA/LCD 自动上料-CG 自动清洁-自动贴附 CG+OCA/CG+LCD 真空贴合-成品精度检测-并自动下料的中尺寸全自动贴合线</p>	<p>产品工艺: CG+OCA+LCD 对应尺寸: 7-17 寸 设备精度: ±0.05mm 设备节拍: 8.0S/Pcs 设备良率: 99%</p>	
<p>全自动中大尺寸 COG 邦定线</p>	<p>设备为 LCD 自动上料-LCD EC 清洗-COG 邦定-FOG 邦定-FOB 邦定-LCD 自动下料的全自动邦定线体</p>	<p>产品工艺: COG-FOG-FOB 邦定 对应尺寸: 10-33 寸 设备精度: X: ±5um; Y: ±5um 设备节拍: 10-17 寸: 邦定单边 2 颗 IC 节拍 ≤ 8s/pcs; 15-33 寸: 邦定单边 8 颗 IC 节拍 ≤ 30s/pcs; 设备良率: 99.8%</p>	

### 3、主要会计数据和财务指标

#### (1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位: 元

	2021 年末	2020 年末	本年末比上年末增减	2019 年末
总资产	2,092,427,705.50	2,200,141,210.06	-4.90%	2,425,111,956.24
归属于上市公司股东的净资产	741,986,249.26	616,034,757.07	20.45%	939,300,119.20
	2021 年	2020 年	本年比上年增减	2019 年
营业收入	1,459,900,056.83	1,197,272,061.32	21.94%	1,045,970,416.22
归属于上市公司股东的净利润	129,777,294.61	-313,096,026.45	141.45%	-924,566,419.10
归属于上市公司股东的扣除非经	9,652,700.59	-316,617,197.82	103.05%	-943,560,933.40

常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	107,076,759.66	40,658,185.88	163.36%	-68,619,541.91
基本每股收益（元/股）	0.36	-0.83	143.37%	-2.42
稀释每股收益（元/股）	0.36	-0.83	143.37%	-2.42
加权平均净资产收益率	19.06%	-40.15%	59.21%	-62.88%

## （2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	411,912,502.39	369,816,838.30	354,167,337.75	324,003,378.39
归属于上市公司股东的净利润	128,595,748.73	29,520,387.47	14,254,635.24	-42,593,476.83
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	27,906,656.18	12,155,408.10	11,440,017.71	-41,849,381.40
经营活动产生的现金流量净额	18,441,588.04	22,310,249.06	-15,387,571.33	81,712,493.89

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是  否

## 4、股本及股东情况

### （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	26,753	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	25,889	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数（如有）	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
景德镇合盛产业投资发展有限公司	国有法人	22.00%	81,230,361	0	质押	39,721,085	
宿迁楚联科技有限公司	境内非国有法人	21.96%	81,077,804	0	质押	79,835,747	
浙江君弘资产管理有限公司—君弘钱江五十七期私募证券投资基金	其他	0.94%	3,480,126	0			
罗旭东	境内自然	0.78%	2,861,294	0			



	人					
陈佩惠	境内自然人	0.73%	2,700,000	0		
黄春芳	境内自然人	0.57%	2,091,000	0		
徐平静	境内自然人	0.47%	1,733,853	0		
叶燕桥	境内自然人	0.36%	1,336,800	0		
彭丽君	境内自然人	0.36%	1,322,000	0		
上海战圣股权投资管理有限公司	境内非国有法人	0.33%	1,200,516	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					

公司是否具有表决权差异安排

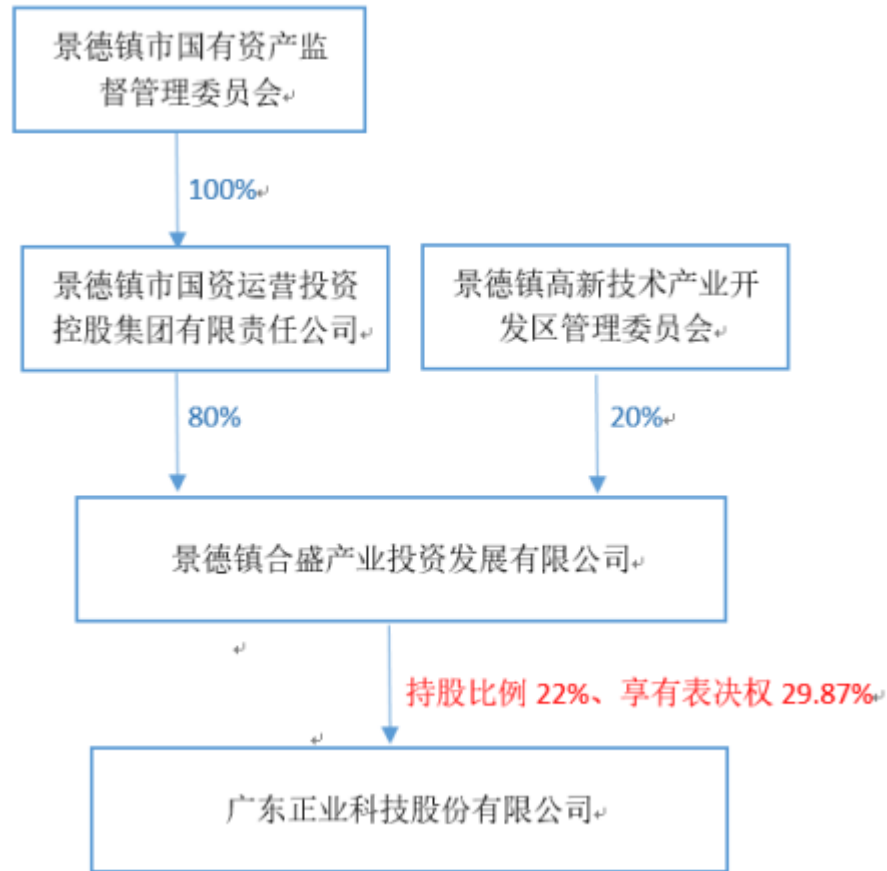
适用  不适用

## (2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

## (3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

适用  不适用

## 三、重要事项

## 1、聚焦“工业检测”主航道

报告期内，公司坚定沿着“工业检测”主航道进行布局，以“光学检测和自动化控制技术”为核心，深耕“锂电、平板显示、PCB”三大主业，积极进军半导体领域。公司营业收入145,990.01万元，同比增长21.94%，实现稳健增长。特别是锂电检测自动化业务实现营业收入62,011.42万元，同比增长151.08%。

## 2、拓展市场新领域，半导体板块布局初见成效

自中美贸易战以来，半导体全产业链亟需国产化与自主可控已成为国内企业共识。基于战略及业务发展需要，公司于2021年成立了半导体事业部，在锂电池检测自动化业务的基础上通过横向发展，将“X光检测技术”应用于半导体领域。针对芯片缺陷的自动检测技术取得重大突破，自主研发的半导体分立元件在线全自动X-RAY检测设备为半导体行业客户解决了检测效率的难题。

报告期内，公司与某全球半导体行业知名厂商签订了8台套搭载了电子光学成像自动识别系统的半导体芯片缺陷检测设备采购合同；与此同时，应用于半导体行业的X-ray点料机、半自动X光检测设备也获得了汽车电子、SMT行业大客户的设备订单，公司在半导体板块布局初见成效，将在2022年加大市场开发力度与提升规模化销售能力。

## 3、持续加大研发投入，夯实核心竞争力

公司坚持自主研发创新与技术服务相结合的研发理念，持续加大研发投入，目前公司拥有高分辨率X射线数字成像理论与应用技术、工业CT设备的非接触式三维高精度扫描成像、智能检测技术、X射线图像2D、3D处理技术等关键技术。2021年9月，正业科技研究院正式成立。公司研究院承接公司整体发展战略，结合公司各板块优势技术研发力量，以软件、算法为核心的多学科综合技术创新领域专业团队为各业务经营单位提供技术难题攻关、解决方案等技术服务，灵活满足全球不同客户的差异化需求；同时，进行公司核心技术和前瞻性技术研究、新兴产业技术培育等工作。让创新成为驱动公司发展的不竭动力，实现以创新驱动发展，靠技术引领未来。

报告期内，公司持续加强核心技术专利布局，完善知识产权保护体系，构建竞争壁垒，截止2021年12月31日，公司累计专利申请678件，授权专利531件，其中已授权发明专利135件，软件著作权212件。与此同时，对研究院的研发项目开发进度与研发成果产业化进度投入更多人力物力，打造技术先发优势，形成市场竞争壁垒。

#### 4、不断提升经营管理水平

2021年，公司通过“抓技术、抓经营、抓管理”等经管措施不断提升经营管理水平，以谋求正业科技高质量发展。公司在报告期内发布了组织管理手册，明确了管理中心的职责，完善了公司组织架构，优化了工作流程，帮助各经营管理单位有序、可控、高效的开展各项工作，提升了集团化管理水平，未来还将持续优化，改革，创新，在管理上再上一个新台阶。

广东正业科技股份有限公司

法定代表人：邓景扬

2022年4月20日